

NQPACK, YQPACK, HQPACK, YQSOCKET をご使用の前に

1. 本製品は、システムでの開発、評価での使用を想定したものです。また、国内の使用に際し、電気用品安全法および電磁波障害対策の適用を受けておりません。開発および評価用のソケットとしてご使用下さい。
尚、NQPACK、YQPACK、HQPACK、YQSOCKET は、RoHS 対応製品です。
2. NQPACK/IC/HQPACK およびNQPACK/YQPACK のシステムは、振動および衝撃環境にはご使用になれません。
3. ご使用する IC は、NQPACK の適合可能な IC 寸法表上でご確認下さい。(同寸法表は、カタログを参照して下さい。)
4. NQPACK/YQPACK/HQPACK をケースから取り出す時、本体を押しえてからスポンジを先に取り出して下さい。
5. ケースを 50℃以上の場所に長時間放置すると、変形する場合がありますので、保管については、40℃以下の直射日光の当たらない場所に置いて下さい。
6. IC をNQPACK に搭載する場合、IC4 隅の樹脂部(封止剤部)のバリがないことを確認して下さい。バリがある場合、ナイフ等で除去して下さい。
7. IC のリードは強度が弱いため、NQPACK へ数回脱着することによりリードが曲がることが多いので、IC をNQPACK へ装着する時、リードの曲がりを点検・補正して下さい。
8. NQPACK にYQPACK/HQPACK をネジ止めする時、添付の専用ドライバー、またはトルクドライバーで4ヶ所のネジを仮止め後、対角にネジを締めて下さい。締め付けトルクの推奨値は $0.054N \cdot m$ ($0.55kgf \cdot cm$)です。1ヶ所のみを強く締めると、接続不良の原因となることがあります。
9. YQPACK、YQSOCKET の抜去時において、こじったり、揺らしたりするとYQPACKのピン曲がりが発生する恐れがありますので、(-)ドライバー等を用い、周りの部品等に注意しながら、4方向から少しずつ抜去して下さい。尚、金属等の硬いものを使用する場合、YQSOCKET等に傷を付けてしまう場合がありますので、先端にテープ等を張り付けてご使用下さい。
10. YQPACK と接続する基板には、所定の位置に部品穴(4ヶ所： $\phi 2.3mm$ 又は $\phi 3.3mm$)が必要です。ネジの頭の大きさ $\phi 3.8mm \cdot \phi 4.3mm$ は配線禁止区域となります。
11. NQPACK をハンダ付けする際、フラックス飛散防止のため、HQPACK をカバーとして被せて下さい。
推奨ハンダ付け条件 ハンダリフロー：260℃×10秒以内、手ハンダ：350℃×5秒以内(1ピン)です。熱風式ハンダ装置のご使用もお奨めします。
12. NQPACK、YQPACK、YQSOCKET は、構造上洗浄液がソケット内に残る恐れがあるので、洗浄は行わないで下さい。
13. NQPACK/IC/YQPACK の組合せでは、ご使用になれません。
14. NQPACK/IC/HQPACK の使用中に温度が上がり、ICの動作が不安定になる場合があります。その場合、扇風機等でコネクタ全体を冷却して下さい。

